

EV GROUP joins hands with ITRI to expand heterogeneous integration process development – August 30, 2022

台北，2022年8月31日—微機電系統（MEMS）、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備之領導廠商EV Group（EVG），今日宣布攜手工業技術研究院（以下簡稱工研院）擴大先進異質整合製程的開發。

在半導體製造中，隨著超越電晶體微縮的更高效能需求提升，3D垂直堆疊與將多種不同的組件與晶粒，從製造、組裝到封裝至單一設備或封裝中的異質整合封裝技術，也促成了高頻寬互連，以提升整體系統的效能，更成為AI人工智慧、自動駕駛與其它高效能運算應用的關鍵驅動力。經濟部多年前就看到此前瞻技術的發展潛力，積極推動「人工智慧晶片異質整合模組前瞻製造平台」及「可程式化異質3D整合」等國家級的研發專案；並支持工研院成立異質整合小晶片系統封裝聯盟（Heterogeneous Integration Chip-Iet System Package Alliance；Hi-CHIP），協助打造包括封裝設計、測試與驗證，及試產生產的完整生態系，已逐步達成供應鏈在地化的目標，更成功擴展商機。由於EVG是Hi-CHIP聯盟成員之一，多套EVG最先進的晶圓接合與微影系統，包括LITHOSCALE®無光罩曝光微影系統、EVG®850 DB自動化剝離系統及GEMINI®FB混合接合系統將於2022年底前進駐工研院3D-IC實驗室；未來將工研院的先進設備導入量產平台後，將協助雙方的共同客戶加速開發全新異質整合製程，拓展至客戶端的晶圓廠。

工研院電子與光電系統研究所副所長駱韋仲表示，工研院的使命為帶動工業發展、創造經濟價值並透過科技的研發增進社會福祉，長期以來持續開發全新3D與異質晶片整合製程，並為供應鏈打造更緊密的合作關係，推進半導體產業持續發展與成長。由於工研院的全自動化量產系統與合作業者的晶圓廠規格相同，包括來自EVG的全新品圓接合與微影解決方案，有利於業者立即將工研院開發的製程配方導入生產過程，加速從實驗室到晶圓廠量產上市時程。

EV Group執行董事會成員暨銷售與客戶支援執行總監Hermann Waltl表示，EVG自1980年在奧地利成立以來，秉持發明（invent）、創新（innovate）、實作（implement）「3I」理念，積極與工研院等全球領先的研究機構合作，加速推動半導體產業未來創新的新技術開發與商業化。EVG目前在全臺皆有優秀的製程與應用工程團隊，過去幾年來已大幅擴展製程相關基礎架構，未來雙方在持續合作下，除了讓EVG取得世界級的研究專業知識，更能進一步強化EVG在臺灣的製程優勢，滿足在臺客戶與合作業者逐步增加的需求與挑戰。

關於工業技術研究院

工業技術研究院是國際級的應用研究機構，擁有六千位研發尖兵，以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉為任務。自1973年成立以來，率先投入積體電路的研發，並孕育新興科技產業；累積超過三萬件專利，並新創及育成包括台積電、聯電、台灣光罩、晶元光電、盟立自動化、台生材等上市櫃公司，帶動一波波產業發展。面對人口往都市集中以及高齡化的趨向，當

科技改變生產及消費模式，氣候變遷帶來2050淨零碳排全新的機會與挑戰，環境與能源改變的催促迫在眉睫，後疫情時代下丕變的國際局勢，工研院聚焦客戶新價值，找出新需求，擘畫「2030技術策略與藍圖」為解決方案，厚植AI、半導體晶片、通訊、資安與雲端、智慧感測等五大智慧化致能技術，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」三大應用領域的研發方向，用科技創新翻轉生活，以市場需求為導向、發展解決方案、創建嶄新市場，以謀求人類社會福祉，引領產業社會邁向美好未來。

<https://news.taiwanet.com.tw/c-1/82565/EV-GROUP%E6%94%9c%E6%89%8b%E5%B7%A5%E7%A0%94%E9%99%A2%E6%93%B4%E5%A4%A7%E7%95%B0%E8%B3%AA%E6%95%B4%E5%90%88%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E9%96%8B%E7%99%Bc.html>